

# 9月21日（火）プログラム一覧

id	date	start	title	author_gr	affiliation_gr
21A1-	19月21日	9:30	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-1 超薄銀フレークと銀粒子を含むフレキシブル銀印刷配線の電気的特性と連続屈曲特性	○前田 和紀、柏木 行康、宇野 真由美	1) 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所
21A1-	29月21日	9:50	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-1 強誘電性高分子の分子量最適化によるソフト触覚センサの作製	○渡邊 侑志1、三浦 礼生1、阿部 真依1、関根 智仁1、竹田 泰典1、洪 振瑞1、熊木 大介、Fabrice Domingues Dos Santos2、宮保 淳3、時任 静士1	1) 山形大学 2) Piezotech株式会社 3) アルケマ株式会社
21A1-	39月21日	10:10	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-1 強誘電性高分子を用いたソフトな動的せん断センサの作製	○三浦 礼生1、渡邊 侑志1、阿部 真依1、関根 智仁1、竹田 泰典1、洪 振瑞1、熊木 大介1、Fabrice Domingues Dos Santos2、宮保 淳3、時任 静士1	1) 山形大学 2) Piezotech 3) アルケマ株式会社
21A2-	19月21日	10:50	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-2 印刷による平面型 NMR コイルの作製と評価	○泉 小波1、藤井 裕2、笈田 智輝2	1) 産業技術総合研究所人間拡張研究センター 2) 福井大学 遠赤外領域開発研究センター
21A2-	29月21日	11:10	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-2 有機薄膜トランジスタ用Ag配線の1軸引張り負荷による抵抗値変動	○中島 太聖1、小金丸 正明1、関根 智仁2、宍戸 信之3、神谷 庄司4、三成 剛生5、池田 徹1、時任 静士2	1) 鹿児島大学 2) 山形大学 3) 近畿大学
21A2-	39月21日	11:30	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-2 有機エレクトロニクス用導電性高分子配線の合掌曲げ疲労評価	○田中 裕大1、小金丸 正明1、宍戸 信之2、神谷 庄司3、関根 智仁4、三成 剛生5、池田 徹1、時任 静士4	1) 鹿児島大学 2) 近畿大学 3) 名古屋工業大学
21A3-	19月21日	13:00	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-3 ストレッチャブル導電性ペースト配線の繰返し引張試験中の電気伝導特性変動に及ぼす変形量の影響	○井上 雅博1、渡辺 輝1、大堤 海翔1、大嶋 玲奈2	1) 群馬大学大学院 理工学府 2) 群馬大学 理工学部
21A3-	29月21日	13:20	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス-3 電鍍メッシュスクリーン版によるコンデンサ内部電極の印刷形成	○古志 知也1、堀井 美徳1、福田 伸子1、野村 健一1、倉田 祐司2、高橋 宗久2、茂木 正2、太田 稔2	1) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 2) 東京プロセスサービス株式会社
21A4-	19月21日	16:45	ヘルスケア/バイオバイオエレクトロニクス 耳標型無線電バイタルセンシングプラットフォーム	○金谷 晴一1、滝口 収2、高橋 秀之3	1) 九州大学大学院システム情報科学研究科 2) アルセンス株式会社 3) 九州大学大学院農学研究院
21A4-	29月21日	17:05	ヘルスケア/バイオバイオエレクトロニクス 405 nmの波長のLEDによるウイルスの殺菌効果	○奥野 敦史1、柳 景仁2、室橋 一智2	1) Green Planets 株式会社 2) G-Smatt Japan 株式会社
21A4-	39月21日	17:25	ヘルスケア/バイオバイオエレクトロニクス メカニカルアーマーを用いた確率的コンピュータの基礎検討	○加藤 康男	1) 長瀬産業株式会社
21B1-	19月21日	9:30	信頼性技術-1 VUV照射によるプラズマインジケータの変色特性	○清水 昭宏1、羽生 智行1、遠藤 真一1、大城 盛作2	1) ウシオ電機株式会社 2) 株式会社サクラクレパス
21B1-	29月21日	9:50	信頼性技術-1 パワーデバイス内部の銅基板-封止樹脂界面における疲労き裂進展則の検討	○高橋 雄太1、池田 徹1、小金丸 正明1、加々良 剛志2、畑尾 卓也2	1) 鹿児島大学 2) 住友ベークライト株式会社
21B1-	39月21日	10:10	信頼性技術-1 新たな冷却加熱方式を用いた熱負荷試験中の電子基板の3次元熱変形およびサーモグラフィカメラ計測	○菊池 郁織1、青木 壮太2、小澤 政孝3、田中 浩和1	1) エスベック株式会社 2) 丸紅情報システムズ株式会社 3) 株式会社日本レーザー
21B2-	19月21日	10:50	信頼性技術-2 Sn酸化被膜に着目したはんだ付け性試験前処理の妥当性検証	○泉水 崇彰<sup>1)</sup></sup>、長居 秀幸<sup>1)</sup></sup>	1) TDK株式会社
21B2-	29月21日	11:10	信頼性技術-2 Sn-Bi系鉛フリーはんだ合金の接合特性	○赤岩 徹哉1、末永 将一1、高村 賢治1、松本 達朗1、竹中 悠真1、西村 哲郎1	1) 株式会社日本スベリア社
21B2-	39月21日	11:30	信頼性技術-2 Sn-Bi系鉛フリーはんだを用いたはんだ接合部のエレクトロマイグレーション	○赤岩 徹哉1、末永 将一1、高村 賢治1、松本 達朗1、竹中 悠真1、西村 哲郎1	1) 株式会社日本スベリア社
21B3-	19月21日	13:00	信頼性技術-3 顕微ラマン分光法とスペクトル解析による多層電極付n形GaIn結晶の高温電子物性に関する研究	○川瀬 幹貴1、須田 潤1	1) 中京大学大学院工学研究科電気電子工学専攻
21B3-	29月21日	13:20	信頼性技術-3 顕微ラマン分光法とスペクトル解析による多層電極付n形ZnO結晶の高温電子物性に関する研究	○加悦 港人1、須田 潤1	1) 中京大学大学院工学研究科電気電子工学専攻
21B3-	39月21日	13:40	信頼性技術-3 顕微ラマン分光法による多層電極付n形4H-SiC結晶の高温状態における熱応力解析に関する研究	○近藤 聖也1、須田 潤1	1) 中京大学大学院工学研究科電気電子工学専攻
21B4-	19月21日	16:45	3次元ICパッケージ 内蔵コイルが及ぼすDC/DCコンバータQFNの熱特性への影響	○大木 康平1、小川 文雄1、岩崎 俊寛1	1) リコー電子デバイス株式会社 経営センター 事業統括部パッケージ技術課
21B4-	29月21日	17:05	3次元ICパッケージ 蓮型多孔質銅製フィンの伝熱性能を高速予測する数値モデルの開発	○榎崎 邦男1、麻 寧緒1、大川 陽子2、田井 友里恵3、井手 拓哉4、大串 哲朗4、村上 政明4、沼田 富行4、水谷 久美子	1) 大阪大学 接合科学研究所 2) 大阪大学大学院工学研究科 3) 大阪大学工学部
21B4-	39月21日	17:25	3次元ICパッケージ Si熱酸化膜上の表面修飾による極薄無電解NiB膜の物性制御	○岡本 尚樹1、山田 尚生1、林藤 壮史1、齊藤 文靖1	1) 大阪府立大学大学院 工学研究科
21C1-	19月21日	9:10	最先端材料-1 動的共有結合樹脂を適用したCFRPの熱プレス成形性評価	○近藤 剛資1、香川 博之1	1) 株式会社日立製作所
21C1-	29月21日	9:30	最先端材料-1 スパッタリングを用いたペーパイト上のSERS構造の形成	○三枝 峻也1、赤松 直哉1、田中 拓1、納屋 昌之2、福岡 隆夫3、内海 裕一1、山口 明啓1	1) 兵庫県立大学 2) 慶応義塾大学 3) 京都大学
21C1-	39月21日	9:50	最先端材料-1 銅系導電性ペーストの電気伝導特性発達に及ぼすオレイン酸とエタノールアミンの同時添加の影響	○井上 雅博1、松浪 由香里1、小田島 大輔2	1) 群馬大学大学院 理工学府 2) 群馬大学 理工学部
21C1-	49月21日	10:10	最先端材料-1 次世代高速通信に向けた液状封止樹脂材料の開発	○鳥越 寛史1、高尾 知哉1、横峯 樹1、村中 義和1、石川 有紀1	1) サンユレック株式会社
21C2-	19月21日	10:50	最先端材料-2 自動車電動化に向けた高耐熱脂環式エポキシ樹脂の開発	○竹中 洋登1、鈴木 弘世1	1) 株式会社ダイセル
21C2-	29月21日	11:10	最先端材料-2 低誘電特性・高耐熱性・高接着性を有する新規エポキシ樹脂の開発	○渡邊 隆明1、西村 雅翔1、木田 紀行1、高橋 淳1	1) 三菱ケミカル株式会社
21C2-	39月21日	11:30	最先端材料-2 クエン酸電解質亜鉛空気一次電池の電解質濃度依存性	○渡邊 敬仁1、松本 圭司1、森 裕幸1、久田 隆史1	1) 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所
21C3-	19月21日	13:00	最先端材料-3 ひずみ負荷に対する電気的特性改善のためのフレキシブル導電性接着剤	○大島 信孝1、吉田 勝大1、松嶋 道也1、福本 信次1	1) 大阪大学大学院工学研究科
21C3-	29月21日	13:20	最先端材料-3 ポリヒドロキシウレタンを用いた伸縮性印刷配線の機械的変形に伴う電気的特性変化挙動の解析	大堤 海翔1、渡辺 輝1、大嶋 玲奈2、○井上 雅博1	1) 群馬大学大学院 理工学府 2) 群馬大学 理工学部
21C3-	39月21日	13:40	最先端材料-3 カーボンナノチューブ分散系における電気伝導特性発達に及ぼす樹脂バインダ配合成分の影響	○辻村 昂1、井上 雅博1	1) 群馬大学大学院理工学府
21C4-	19月21日	16:45	先端インターコネクト 300°C高温放置によるマイクロサイズ銀粒子焼結層の微細組織変化	○淀 将悟1,2、霍 福鵬1,2、西川 宏2	1) 大阪大学大学院工学研究科 2) 大阪大学接合科学研究所
21C4-	29月21日	17:05	先端インターコネクト 液体金属GaとCu電極界面のエレクトロマイグレーション現象	○小澤 龍生1、改原 グスタヴォ ヨウスケ1、朝日 柊介1、田口 博久1、山中 公博	1) 中京大学工学部電気電子工学科
21C4-	39月21日	17:25	先端インターコネクト ファンアウト配線を利用したフレキシブルフルカラーマイクロ LED ディスプレイの作製技術	○王 詰1、荒山 俊亮2、煤孫 祐樹1、小田島 鞏1、木野 久志3、田中 徹1,4、福島 豊史14	1) 東北大学工学研究科 2) 東北大学工学部 3) 東北大学学際科学フロンティア研究所
21C4-	49月21日	17:45	先端インターコネクト 反応性スパッタリングによるTi系MAX合金配線材料の物性評価	○若松 和伸1、上田 和貴2、岡本 尚樹1、齊藤 文靖1	1) 大阪府立大学大学院工学研究科 2) 大阪府立大学工学域